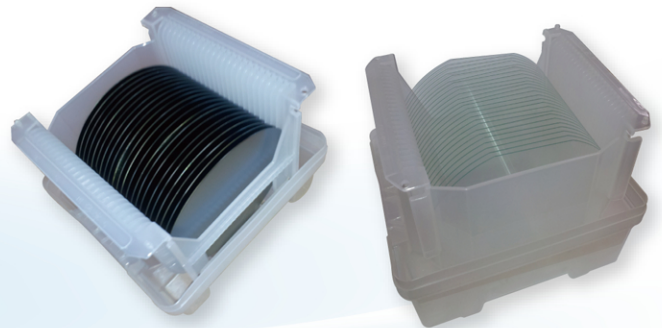
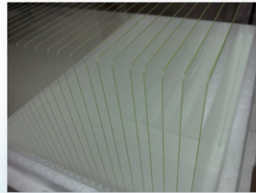
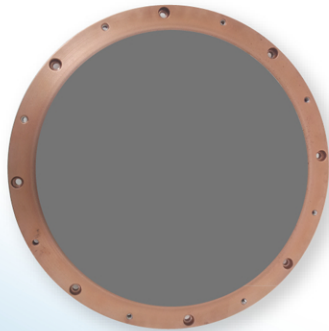
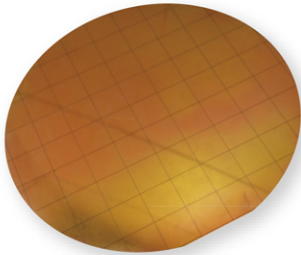


FINE SCIENCE

[www.finesc.com](http://www.finesc.com)

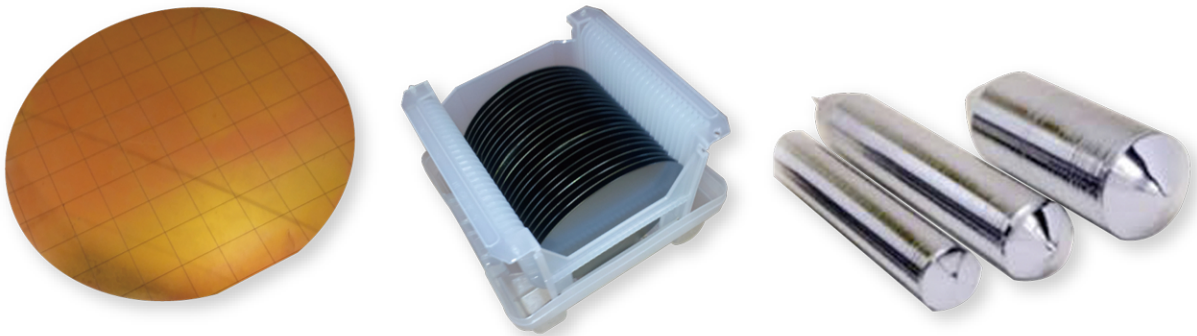


# SEMICONDUCTOR MATERIALS

## NEW PRODUCT CATALOG

FINE SCIENCE 화인사이언스

## Silicon wafer



Diameter	2~12 Inch
Growing method	CZ, FZ
Grade	Prime, Test, Dummy
Type/Dopant	P-type(Boron), N-type(Phosphorus, Antimony, Arsenic)
Orientation	<100>, <110>, <111>
Resistivity	Min,0.001–Max,20,000 ohm.cm
Thickness	Semi Standard
Surface	Single side polishing, Double side polishing, As cut

### 국제 Semi Standard Specification

Diameter	Thickness	Primary Flat Length	Secondary Flat Length
2"	275±25um	15.88mm	8mm
3"	375±25um	22.22mm	11.18mm
4"	525±25um	32.5mm	18.00mm
5"	625±25um	32.5mm	18.00mm
6"	675±25um	57.5mm	37.50mm
8"	725±25um	—	—

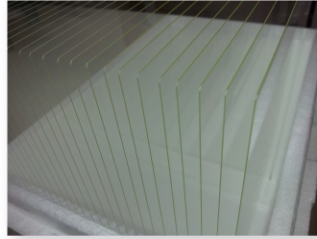
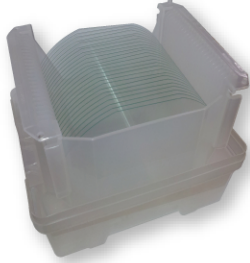
\*추가 공정 서비스도 가능합니다.

산화막 공정(Oxidation)

다이싱(Dicing)

박막증착 공정(Thin film deposition)

## Glass / Quartz / Sapphire



### Quartz wafer

Property	Fused Silica Standard, Semi Dry, Dry, Very Dry	Fused Quartz Electric Fused, Flame Fused
Diameter	2", 3", 4", 5", 6", 8", Square type	2", 3", 4", 5", 6", 8", Square type
Grade	UV Grade	Optical Grade
Thickness	0.2mmT~1mmTh / 기타두께	0.2mmT~1mmTh / 기타두께
Surface	Double side polishing	Double side polishing

### Sapphire wafer

Chemical Formula	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Diameter	2" (50.8mm), 3" (76.2mm), 4" (100mm), 6" (150mm)
Orientations	C-plane [0001], R-plane [1012], A-plane [1120], M-plane [1010]
Thickness	330μm, 430μm, 460μm
Surface	Single Side Polished , Double Side Polished

### ITO Glass

Product	ITO coated Sodalime glass
Size	고객 요청 Size 가능
Glass thickness	0.5~1.1mmTh / 기타두께
ITO thickness	350~3000Å
ITO Resistance	5~100ohm.cm

### FTO Glass

Product	FTO coated Sodalime glass
Size	고객 요청 Size 가능
Thickness	2.2mm / 3.2mm
FTO Resistance	7, 15ohm.cm

### EXG Glass

Size	고객 요청 Size 가능
Thickness	0.4mm, 0.5mm, 0.7mm / 기타두께

### Boro 33 glass / Pyrex glass

Size	고객 요청 Size 가능
Thickness	0.7mm, 1.1mm, 1.75, 2.2mm / 기타두께

### Sodalime glass

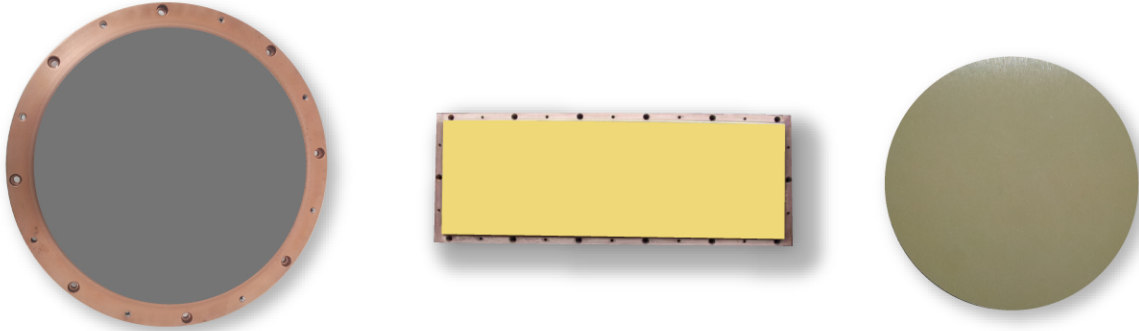
Size	고객 요청 Size 가능
Thickness	0.55mm, 0.7mm, 1.1mm / 기타두께

\*다이싱(Dicing) 및 박막증착(Thin film deposition) 서비스를 제공하고 있습니다.

\*상기 표기된 제품 이외의 기타 재질의 Substrate를 다양하게 제공하고 있습니다.



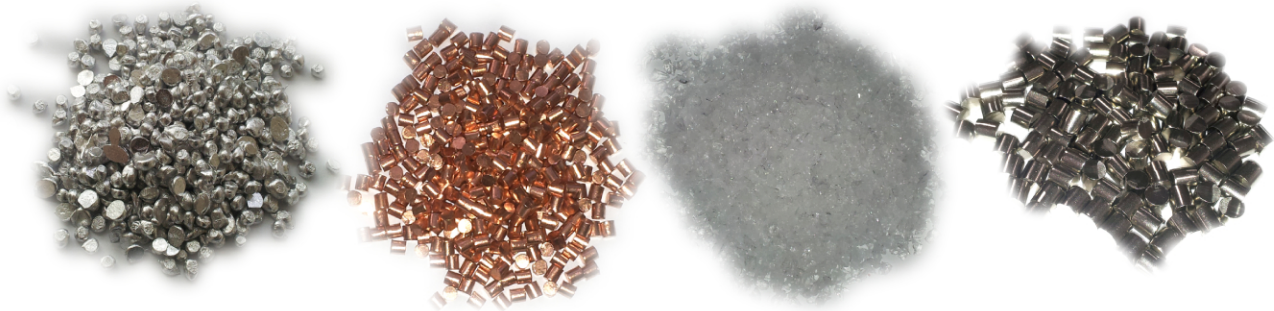
## Sputtering target



순수금속(Pure metal) / 합금(Alloy) / 산화물(Oxide) /  
 불화물(Fluoride) / 탄화물(Carbide) / 질화물(Nitride)

\*다양한 조성의 Target제조 및 Backing plate & Bonding 서비스를 제공하고 있습니다

## Evaporation material



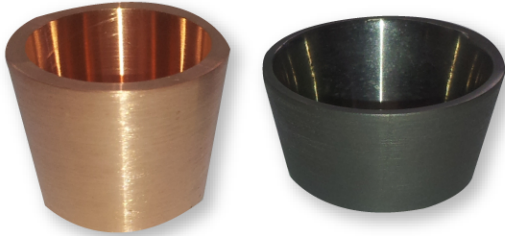
순수금속(Pure metal) / 합금(Alloy) / 산화물(Oxide) /  
 불화물(Fluoride) / 탄화물(Carbide) / 질화물(Nitride)

\*다양한 조성의 E-beam evaporation, Thermal evaporation 증착 재료를 제공합니다.

\*Granule, Pellet, Sheet 등 기타 다양한 형태 및 사이즈 제작 가능합니다.

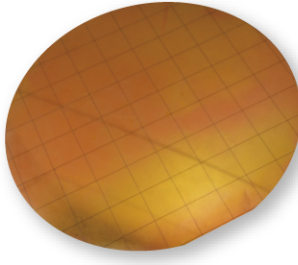
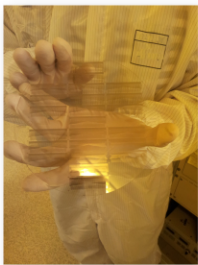


## 진공증착 소모품



텅스텐(W), 몰리브데늄(Mo) 등 다양한 재질 사이즈의 Boat, Crucible, Filament 제작이 가능합니다.

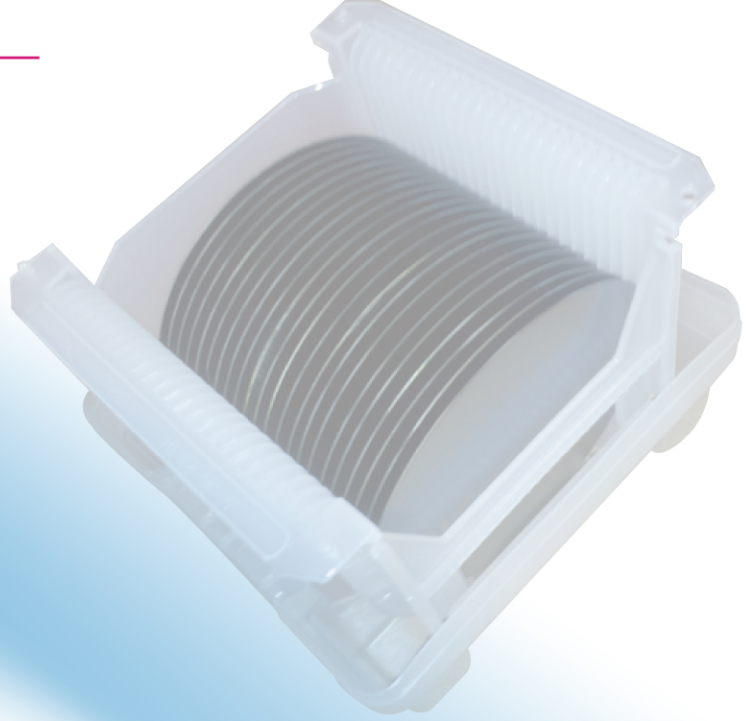
## 공정서비스



- 산화막 공정(Thermal Oxidation)  
: Wet (3000 Å ~ 3um) / Dry (1000 Å ~ 3000 Å)
- 다이싱 공정(Dicing process)  
: 0.1~10mm 의 Si, Quartz, glass등의 기판을 원하시는 크기로 공급 합니다.
- 박막증착(Thin film deposition)  
: Sputtering, E-beam 방식으로 다양한 물질의 박막코팅이 가능합니다.
- 타겟 백플레이트 본딩(Back plate & Bonding)  
: 요구에 따른 각종 타겟의 Back plate 제작 및 본딩 서비스를 제공합니다.

## Semiconductor materials

- ◆ Silicon wafer
- ◆ Glass wafer
- ◆ Substrate
- ◆ 진공증착재료
- ◆ 박막소재



FINE SCIENCE 화인사이언스

서울시 구로구 구로중앙로 198 구로기계공구상가 B블럭 13동 223호  
TEL : (02) 2636-8242 FAX : (02) 2636-8244  
[www.finesc.com](http://www.finesc.com)